



Uwaga : Do klejenia płyt izolacji termicznej używa się zaprawy klejowej do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowego podłoża budowlanego.

Zaprawę klejową przygotować wg zaleceń producenta.

Klej nanosić na płyty wg tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1-2 cm) zapewnić min. 40 % efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża. Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nanieść min. 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Przy wyborze systemu ocieplenia należy się kierować wytycznymi producenta wybranego systemu.

**RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.**

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AKON"		BRANŻA:	ARCH.
10 - 672 OLSZTYN UL. ELBLĄSKA 125		SKALA:	1:10
OBIEKT:	WSZ - PAWILON WIELOFUNKCYJNY	DATA:	03.2013
ADRES:	WSZ Elbląg, ul. Królewiecka 146, dz. nr 6/4	NR RYS.:	D-6
TEMAT:	Detal 6: Sposób klejenia płyt izolacji termicznej - styropian	PROJ.	BUDOWLANY
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marian Ceynowa	Upr. bud. nr:	53/99/OL
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Iwona Malinowska-Klimek	Upr. bud. nr:	3/WMOKK/2008
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Danuta Florczykowska	Upr. bud. nr:	